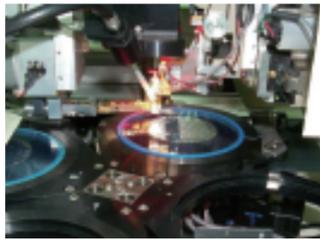
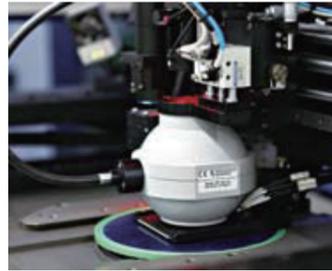




最廣泛使用的晶圓載具，適用於低成本，擴張需求的晶片承載



Die Bonder  
LED/IC Sorter  
LED/IC Prober  
LED Breaker  
Bad die Sorter



### 超高強度 GR8-A 系列

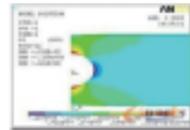
GR8-A 系列實現業界最高強度需求，內圈採用高強度鋁合金製成，成功解決擴張後藍膜變形的問題。本款大量運用於 LED 晶粒揀選製程，確保藍膜在揀選過程不變形，避免錯位問題產生。

Patent Pending

### 採用更強的材料，提升使用壽命

GR系列提供高品質的擴張功能以及世界一流的強度保證，無論壽命還是擴張緊密度都十分出色。高緊密度配合擴張功能的運用，夠穩固膜上的晶圓，因此是各種LED/IC晶片載具的理想選擇

GR間隙設計與高精密度的外型製作，除了使擴張緊度得到了最大限度的提升外，在使用壽命上，更實現最高的等級，這種無與倫比的效能與品質部分程度上歸功於採用了獨自開發的高強度材料技術。



#### 規格表 Product Lineup Table

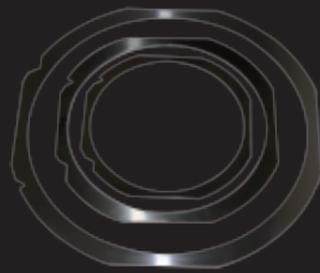
Dimension	Model 型號	Color 顏色	ID/OD 內徑/外徑
1	GR-4 適用4吋 IC or 2吋LED Wafer	● ID / ○ OD	ID / OD
2	GR-5 適用4吋 IC or 2吋LED Wafer	● ID / ○ OD	ID / OD
3	GR-6 適用4吋 IC or 2吋LED Wafer	● ID / ○ OD	ID / OD
4	GR-8 適用4吋 IC or 2吋LED Wafer	● ID / ○ OD	ID / OD
4	GR-8A 適用4吋 IC or 2吋LED Wafer	● ID / ○ OD	ID / OD

#### 規格表 Product Lineup Table

Dimension	Model 型號	Color 顏色	ID/OD 內徑/外徑
5	GR-4	● ID / ○ OD	ID / OD
6	GR-5	● ID / ○ OD	ID / OD
7	GR-6	● ID / ○ OD	ID / OD
8	GR-8	● ID / ○ OD	ID / OD

#### 尺寸圖 Dimension (mm)

1		2		3	
4		5		6	
7		8		9	



最高品質的晶圓載具，適用於切割機及挑檢機擴張需求的晶片承載



尖端的防鏽技術

與日本技術合作，經過ASTM認證，CHT產品防鏽能力為6~9級，高於一般公司之製品，避免生鏽問題產生。



最專業的熱處理技術，提升壽命

我們提供世界一流的強度與硬度保證，無論壽命還是剛性都十分出色。台灣最專業的專業熱處理技術並採用日本JFE不鏽鋼，ASTM認證CHT產品硬度為79HRA並兼具韌性需求，高於一般公司之製品。更高的硬度，更耐刀片切割，延長Film Frame使用壽命

全自動拋光生產技術

日本技術轉移，唯一採用全自動拋光製程的技術領導廠商，保證產品品質均一，解決人工拋光會造成



品質不均的問題。ASTM 認證CHT產品表面粗糙度優於一般公司手動拋光之製品，有效提升鐵環防鏽等級，且藍膜黏貼品質更佳，減少氣泡產生。

超音波清洗/烘烤/抗氧化處理

導入日本超音波清洗/烘烤/抗氧化處理設備，6槽6道製程，達到高標準清洗、抗氧化處理需求，其餘公司只採用3槽超音波水洗製程，



抗氧化功能有限

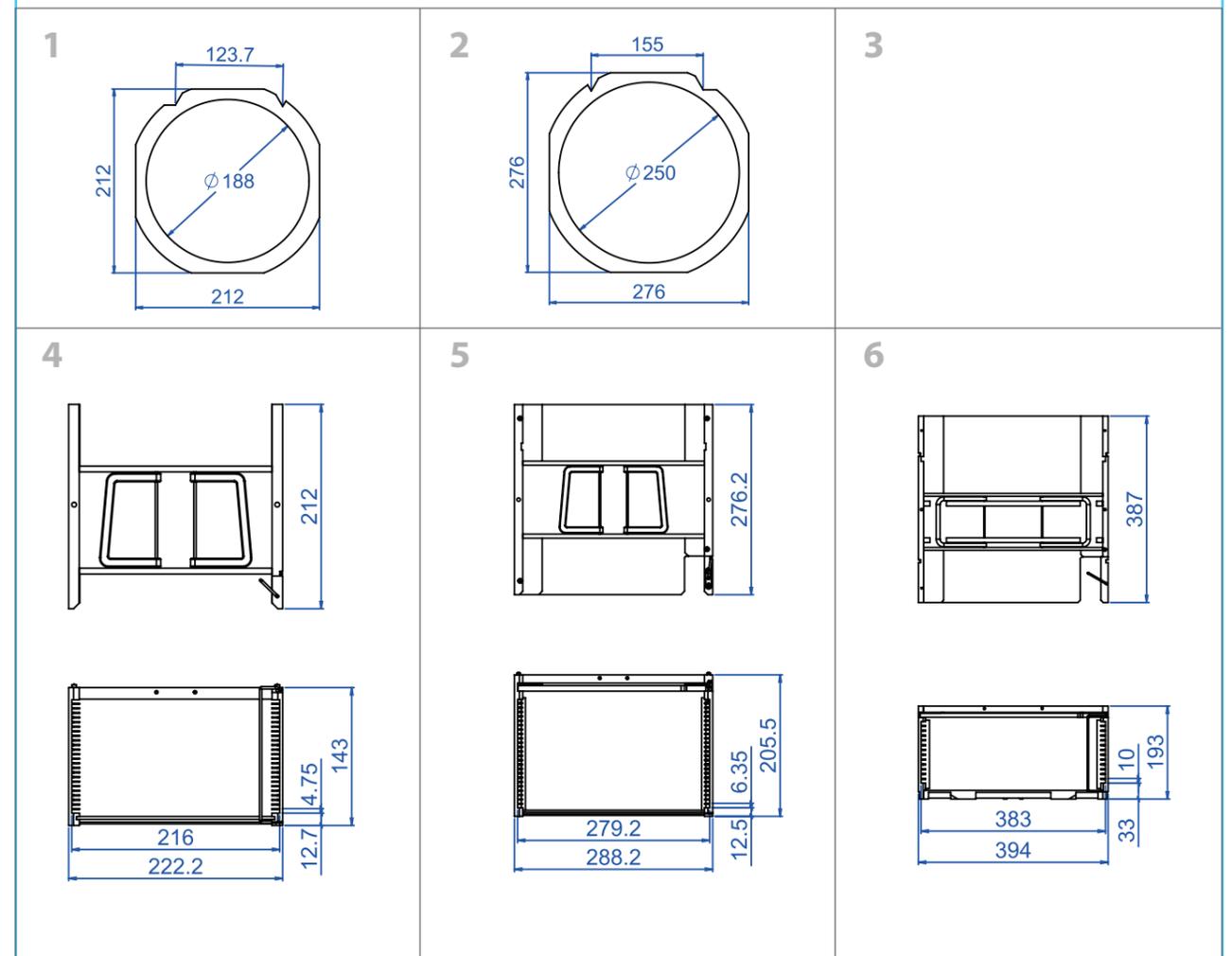
金屬鐵片規格表 Lineup of DISCO Metal Frame

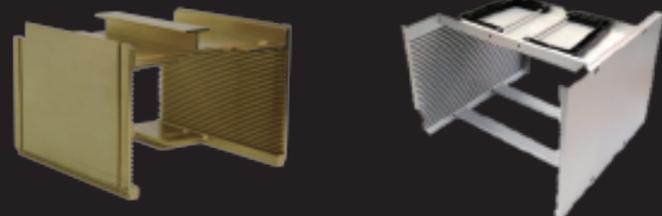
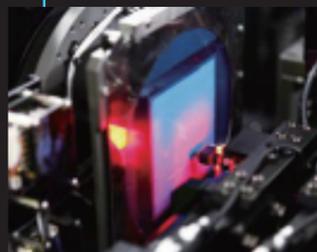
Dimension	Model 型號	Wafer Size 晶圓尺寸	Material 材料
1	DTF 2-6-1	ø 6 inch	JEF-SUS420J2
2	DTF 2-8-1	ø 8 inch	JEF-SUS420J2
3	DTF 2-12-1	ø 300mm	JEF-SUS420J2
4	GR-8		ID / OD
4	GR-8A		ID / OD

卡匣規格表 Lineup of Cassette

Dimension	Model 型號	Wafer Size 晶圓尺寸	Number of slot 槽數
5	DTC 2-6-1	ø 6 inch	25 slot
6	DTC 2-6-1	ø 6 inch	25 slot
7	DTC 2-6-1	ø 6 inch	13 slot
8	GR-8		ID / OD

尺寸圖 Dimension (mm)

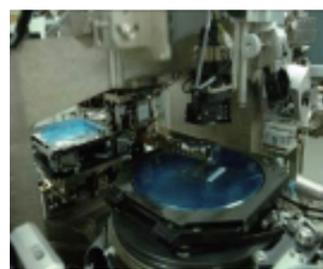




最高品質的晶片載具，適用於LED晶粒挑檢機分類需求



LED Mapping Sorter



專利的卡匣背擋磁鐵設計

卡匣磁性背擋設計可將Bin frame牢固吸附，避免鐵環在運送過程中滑落使晶片毀損。專利性的背擋設計，無論磁鐵耐用度與磁力都得到大幅度的提升，目前已獲得各大LED廠採用，並列為標準配備。

Patent Pending

尖端的防鏽技術

與日本技術合作，經過ASTM認證，CHT產品防鏽能力為6~9級，高於一般公司之製品，避免生鏽問題導致的晶片汙染產生。



CHT台灣製



他廠

台灣製造，採用JEF鋼材

所有鐵環製造商皆移往在中國生產，CHT為確保高品質承諾，與日本技術合作，引進自動化生產線在台製造高品質鐵環，除了有效降低成本，更提高品質均一性及生產彈性。CHT也是唯一敢保證，只採用JEF高品質的不鏽鋼材料，我們與日本JFE鋼廠同盟，確保穩定取得高品質的鋼料，提供客戶更高及時供貨保證。

最專業的熱處理技術，提升壽命

我們提供世界一流的強度與硬度保證，無論壽命還是剛性都十分出色。台灣最專業的专业熱處理技術並採用日本JFE不鏽鋼，ASTM認證CHT產品硬度為79HRA並兼具韌性需求，高於一般公司之製品。更高的硬度，更耐刀片切割，延長Film Frame使用壽命

金屬鐵片規格表 Lineup of DISCO Matel Frame

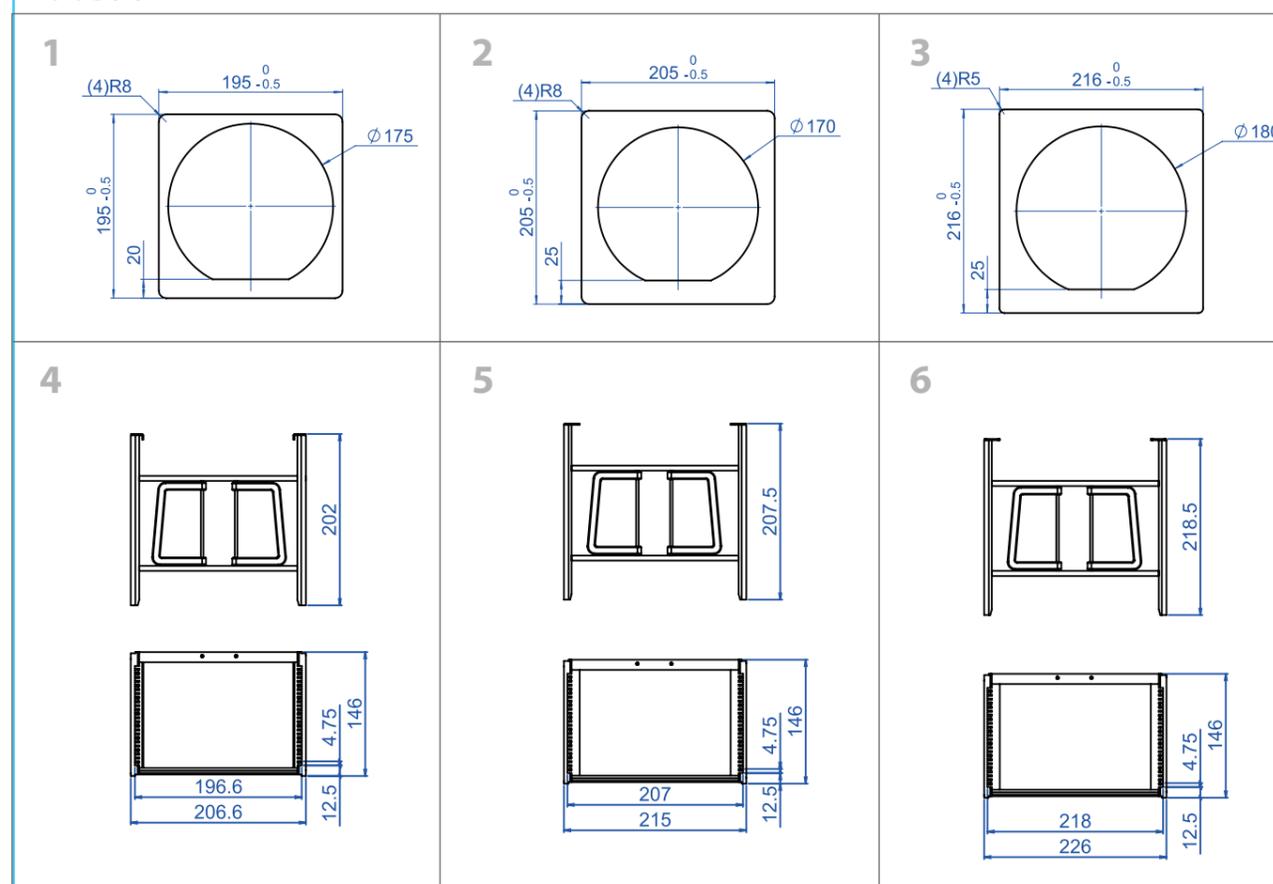
Dimension	Model 型號	Thickness 厚度	Material 材料
1	BF195-20	1mm	JEF-SUS420J2
2	BF 205-30	1mm	JEF-SUS420J2
3	BF 216-25	1mm	JEF-SUS420J2

卡匣規格表 Lineup of Cassette

Dimension	Model 型號	Bin frame 適用鐵環	Number of slot 槽數
4	BC195	195x195	25 slot
5	BC 205	205x205	25 slot
6	BC 216	216x216	25 slot

超過數十種標準模具，規格種類繁多，請來電詢問，任何尺寸皆可客製化製作

尺寸圖 Dimension (mm)





便利使用的晶圓載具，適用於LED Sorter/Prober/AOI晶片承載需求



100台Sorter-採用磁扣式Wafer Frame 可節省 US63萬以上的人力費用

Wafer frame	100台Sorter 生產片數(月)	更換單片子 母環時間(秒)	每月OP所需更換 子母環時間(小時)	OP (人)	設備使 用年限	每月工資 (美元)	總人力投資 (美元)
鎖固式	125,000	100	3,472	19.7	7	450	745,739
磁扣式	125,000	15	521	3	7	450	111,861

註：以產能10x23mil, Sorter月產能15kk計算，每台Sorter每月可生產1250片 Wafer。

2. 晶片尺寸更大，換片更頻繁，效益更高

節省超過85%的更換時間

**磁扣式程序**

- 拿下磁扣環
- 放入子母環
- 放下磁扣環

15秒內完成

**鎖固式程序**

- 旋開3顆螺絲
- 放入子母環
- 調整壓板位置後旋入3顆螺絲

超過100秒完成

超過上萬片的市場驗證

我們提供客製化LED/IC生產線使用快拆式Frame設計，為客戶降低成本提高產能，是我們持續努力的重點。  
AW系列的磁扣式Wafer Frame已被大量使用於LED設備的 Sorter/Prober/AOI上，並獲世界知名設備廠指定使用。

註：壓板式會有鋁圈滑牙、螺絲損壞的缺點

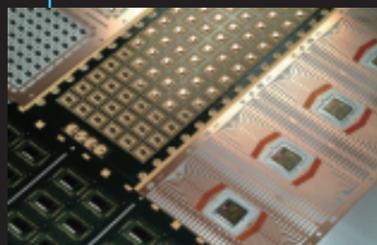
金屬鐵片規格表 Lineup of DISCO Matel Frame

Dimension	Model 型號	Wafer Size 晶圓尺寸	Mapping Soter 適用設備
1	MSWFM6 (磁扣式)	ø 6 inch	MS100
2	MSWFM7 (磁扣式)	ø 2 inch	MS100
3	MSWFD6 (磁扣式)	ø 2inch	DL 899
4	MSWFS6 (鎖固式)	ø 2inch	MS100
5	MSWFS7 (鎖固式)	ø 4inch	MS100

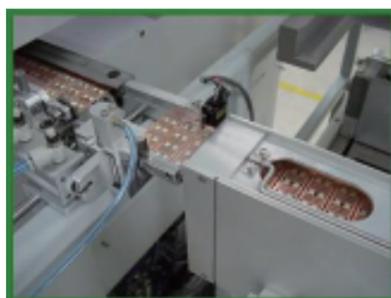
卡匣規格表 Lineup of Cassette

Dimension	Model 型號	Mapping Soter 適用設備	Number of slot 槽數
6	DLWC	DL 899	10 slot
7	MSWC	MS100	8 slot

尺寸圖 Dimension (mm)



大量用於 IC與LED 設備的 Leader frame 承載需求



Die Bonder  
Wire Bonder  
Molding  
Plating  
Marking  
Trim & Form



客製化製作生產

可快速依客戶圖面與 Leaderframe 規格配合製作,

- Lead Frame / Strip Width
- Lead Frame / Strip Length
- Lead Frame / Strip Thickness
- Dust Covers
- Alodine Colors 陽極顏色

台灣製造、品質保證

CHT供應生產線使用之彈匣遍及全球市場，數百種系列彈匣已被大量使用于國內外各大半導體廠內的黏晶機與鐳線機上，並獲世界知名封裝廠指定使用。我們在台灣建立一貫的自動化生產流程，配合嚴謹的品質管理與材料選用，除了提供高質量的產品外，為客戶降低成本，是我們持續努力的重點。



各類 Prober 點測的VMI body

我們提供各式的精密手調平台的客製化設計與製造。目前開發 LED 測試機專用的VMI body，已獲得各大廠的認可與採購。重預壓的客製化滑軌，搭配CHT 高精密的加工技術與嚴謹的品質管理/LED 的黏晶機與晶片揀選機上，在小晶粒(7x9mil)的高壽命表現，是我們獲世界知名LED廠指定使用的重要原因。

頂針蓋

我們供應各類型IC與LED的黏晶機與晶片揀選機頂針蓋。同時也可快速依客戶圖面進行客製化製作，材質有鋁、塑鋼可供選擇。

橡膠吸嘴 頂針

CHT供應高品質橡膠吸嘴與頂針，優異的吸嘴耐磨耗性能，大量使用於 IC/LED 的黏晶機與晶片揀選機上，在小晶粒(7x9mil)的高壽命表現，是我們獲世界知名LED廠指定使用的重要原因。

晶粒挑揀機部品零件

我們供應各類型IC與LED的黏晶機與晶片揀選機頂針蓋。同時也可快速依客戶圖面進行客製化製作，材質有鋁、塑鋼可供選擇。

橡膠吸嘴 頂針

CHT供應高品質橡膠吸嘴與頂針，優異的吸嘴耐磨耗性能，大量使用於 IC/LED 的黏晶機與晶片揀選機上，在小晶粒(7x9mil)的高壽命表現，是我們獲世界知名LED廠指定使用的重要原因。



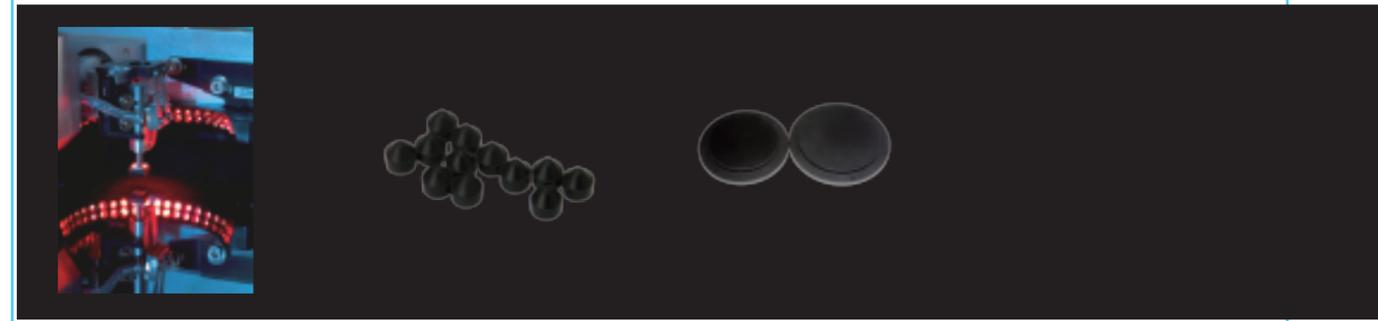
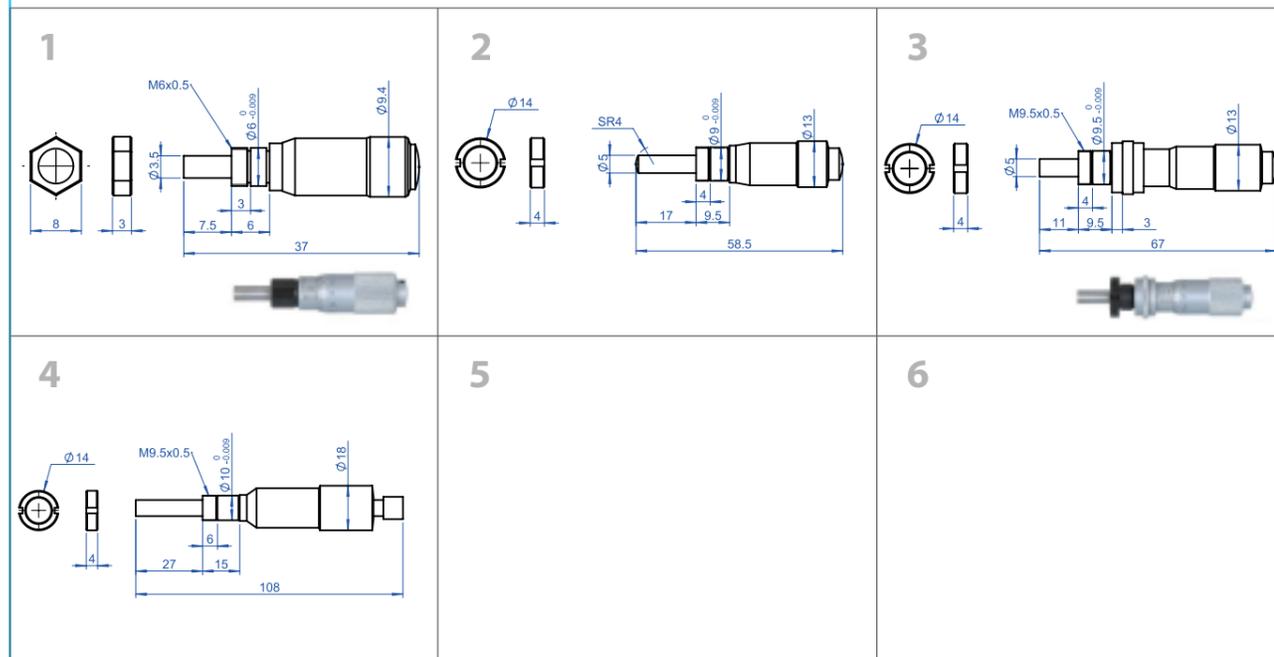
解析度0.01mm，高品質製作，  
確保再現性需求

規格表 Lineup of Micrometer Heads

Dimension	Model 型號	Stroke 行程	最小讀取量/每旋轉一圈移動量
1	MEH 6.5-N	6.5	0.01/0.5
2	MEH 13-N	13	0.01/0.5
3	MEH 13-T	13	0.01/0.5
4	MEH 25-N	25	0.01/0.5

標準規格種類繁多，請來電詢問，任何尺寸皆可客製化製作

尺寸圖 Dimension (mm)



精密手調平台

我們提供各式的精密手調平台的客製化設計與製造。其中VB (VMI Body) 系列，是針對LED 點測機所開發而成，重預壓的客製化滑軌，搭配CHT 高精密的加工技術與嚴謹的品質，目前已獲得各LED大廠的認可與採購。



各類 LED Prober 點測的VMI body

頂針蓋

我們供應各類型IC與LED的黏晶機與晶片揀選機頂針蓋。同時也可快速依客戶圖面進行客製化製作，材質有鋁、塑鋼可供選擇。



橡膠吸嘴 頂針

CHT供應高品質橡膠吸嘴與頂針，優異的吸嘴耐磨耗性能，大量使用於 IC/LED 的黏晶機與晶片揀選機上，在小晶粒(7x9mil)的高壽命表現，是我們獲世界知名LED廠指定使用的重要原因。



LED 晶粒挑揀機、點測機部品零件

我們供應各類型IC與LED的黏晶機與晶片揀選機頂針蓋。同時也可快速依客戶圖面進行客製化製作，材質有鋁、塑鋼可供選擇。



橡膠吸嘴、頂針

CHT供應高品質橡膠吸嘴與頂針，優異的吸嘴耐磨耗性能，大量使用於 IC/LED 的黏晶機與晶片揀選機上，在小晶粒(7x9mil)的高壽命表現，是我們獲世界知名LED廠指定使用的重要原因。